

作者是 系統管理員
週五, 06 五月 2011 00:00 - 最近更新 週二, 27 十二月 2011 14:17

國際製造工程學會，近期將開辦一年一度的國際電子製程工程師認證班，非常歡迎各界人士參加，並提升電子相關學知識。

時間	課程名稱	時數	補助費
2011/07/31 (日)-08/06 (六)-08/07 (日)	奈米積體電路可生產性與良率設計	18	全額費用 US\$1000 補助金額 \$100

本課程為海外電子產業加工業、電子組裝業、特約服務、元件組裝加工業和組裝、組裝與元件半導上議。

課程內容包括電子組裝設計技術趨勢及未來電子組裝設計技術趨勢、課程內容包括電子組裝設計技術趨勢、課程內容包括電子組裝設計技術趨勢。

- 課程內容
- 1. 電子組裝設計 (Electronic Assembly)
 - 2. 奈米積體電路 (Nanometer Technology)
 - 3. 奈米積體電路、奈米積體電路 (Nanometer Yield - Lithography)
 - 4. 奈米積體電路、奈米積體電路 (Nanometer Yield - Chemical Mechanical Polishing (CMP))
 - 5. 奈米積體電路、奈米積體電路 (Nanometer Yield - Parametric Yield)
 - 6. 奈米積體電路 (Group for Yield)
 - 7. 奈米積體電路 (Yield Prediction)
8. 結論 (Conclusion)

報名日期 2011/07/31 - 2011/08/06

課程時間	課程名稱	時數	優惠資訊
2011/05/26 (週五) - 2011/05/27 (週六)	國際電子製程工程師認證班	57小時	05/26前報繳，享89折優惠

國內第一屆國際製造工程學會國際電子製程工程師認證班

本課程為海外電子產業加工業、電子組裝業、特約服務、元件組裝加工業和組裝、組裝與元件半導上議。課程內容包括電子組裝設計技術趨勢及未來電子組裝設計技術趨勢、課程內容包括電子組裝設計技術趨勢、課程內容包括電子組裝設計技術趨勢。

報名日期 2011/07/31 - 2011/08/06

作者是 系統管理員

週五, 06 五月 2011 00:00 - 最近更新 週二, 27 十二月 2011 14:17

(課程內容請參考專門課程)

【新竹】現場課程	課程名稱	時數
2011/06/10	晶圓材料製程介紹	6小時
2011/06/17	半導體製造技術導論	6小時
2011/06/24,07/01	半導體製程介紹	12小時
2011/07/15	I.C封裝製程介紹	6小時
2011/07/22	I.C測試製程介紹	6小時
2011/07/29	電路板製程介紹	6小時
2011/08/05	電子組裝製程介紹	6小時
2011/08/19,26	LCD製程介紹	6小時
數位網路非同步	電子製造價值鏈及元件介紹	3小時
定期上網	認證考試	

Ü專業講師親授培訓學習正確的電子製程知識

作者是 系統管理員

週五, 06 五月 2011 00:00 - 最近更新 週二, 27 十二月 2011 14:17

Ü重視演練.課後能將知識運用自如

Ü有效引導思考.學習成效高